

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2026年4月15日 龙迅股份2025年年度业绩说明会）

编号：LT2026-001

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与龙迅股份2025年年度业绩说明会的全体投资者 |
| 时间 | 2026年04月15日 15:00-16:00 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：FENG CHEN 先生 独立董事：陈来先生 独立董事：文冬梅女士 独立董事：黄绮汶女士 董事会秘书：赵彧女士 财务负责人：韦永祥先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 交流的主要问题及回复 一、预征集问答 1、尊敬的陈董，您好！公司多次提及跟英伟达合作，目前已经部分量产；请问主要跟英伟达在游戏、汽车业务还是AI算力上？主要提供哪方面的产品？未来的体量预计有多大？ 答：尊敬的投资者，您好！依托与英伟达的生态合作，公司相关互连芯片和智能视频芯片的市场认可度进一步提升，公司与英伟达在智能座舱、ADAS、车载显示、高端显示领域保持深度参考设计合作，部分产品已量产，协同效应持续释放，未来随着车载与高端显示需求放量，业务规模具备持续扩张潜力。具体进展 |

详见后续公告，感谢您的关注与支持！

2、芯片企业，总体来说技术更新较快；人才非常重要，公司的研发中心设在合肥，在国内，相对来说长三角地区，上海是不是跟符合公司吸引更多优秀人才，公司有没有考虑在上海成立子公司的计划？公司目前有没有更好的政策吸引更多优质人才？

答：尊敬的投资者，您好！半导体行业技术迭代快速，核心人才是企业创新发展的关键要素。公司深耕合肥研发基地，依托区域产业与科教资源，已构建稳定成熟的研发团队。同时公司充分认可上海作为长三角集成电路核心城市的人才集聚与产业协同优势，现阶段暂无设立上海子公司的相关规划，未来若有区域布局调整计划，公司将严格依规及时履行信息披露义务。人才建设方面，公司始终将引才、育才、留才置于战略高度，持续搭建完善的培养体系与双通道发展路径，建立具备市场竞争力的薪酬体系，配套绩效奖励、股权激励等多元化长效激励机制，持续优化研发创新环境。此外，公司积极推进H股上市布局，依托国际化平台进一步拓宽人才引入渠道，持续吸纳行业优质人才，稳固研发核心力量，为公司长期高质量发展提供坚实支撑。感谢您的宝贵建议以及对公司的关注与支持！

3、尊敬的陈总，您好！AI及HPC领域收入规模2025年多少？公司开发PCIe/CXL/USB的Retimer及Switch，其中PCIe5.0 Retimer（可与CXL2.0兼容）已取得显著进展；目前是否流片？另外Switch进展如何？另外公司车规级认证持续完善，自研ADP协议的车载SerDes进展情况，以及市场推广如何？

答：尊敬的投资者，您好！AI及HPC领域作为公司的战略新业务方向，是公司全新成长赛道，根据已公开数据，该领域2025年前三季度收入占公司前三季度总收入2%左右。PCIe5.0 Retimer（兼容CXL2.0）目前在设计开发中，计划2026年上半年完成流片。面向数据中心与AI集群，用于多设备扩展、算力池化、GPU直连互联的PCIe5.0 / CXL2.0 Switch目前处于规划与预研阶段。USB相关产品作为高速互连产品线的重要部分，目前处在研究开发中，具体进展详见后续公告。智能车载作为公司的业务新增长曲线，公司持续强化该领域建设，截至目前，公司已有

20 款车载芯片通过 AEC-Q100 认证，车载 SerDes 芯片组已全面推向市场。近期，顺利通过 ISO26262:2018 功能安全管理体系认证，此次认证通过，表明公司已建立起完善的功能安全管理体系，可满足智能座舱、ADAS 等核心车载场景的严苛安全要求，技术实力与管控水平全面接轨国际标准。公司将持续推进包括车载 SerDes 在内的汽车电子业务，具体进展详见后续公告，感谢您的关注与支持！

4、尊敬的陈总，您好！最近几年龙迅股份的营收规模确实有很大的增长，但不管在上市公司，还是在半导体行业中，其规模仍然偏小，公司未来有没有可能实现百亿营收这样的可能性？

答：尊敬的投资者您好！公司近年营收保持稳健增长，2025 年实现营业收入 5.68 亿元，同比增长 21.93%，现阶段规模仍处于高速混合信号芯片设计领域的成长阶段。对标行业头部企业，公司当前经营规模仍有较大提升空间。中长期来看，公司将持续聚焦主业，深耕核心技术研发，迭代升级核心技术平台，不断完善车载、AR/VR、AI 及 HPC 等新兴领域产品布局，紧抓半导体国产替代及下游新兴行业发展机遇，持续拓展优质客户、提升市场占有率与经营规模。对于长远发展，公司管理层具备清晰的战略规划与充足信心，将依托技术、产品及客户优势稳步做大做强。关于远期经营规模目标，公司暂不做量化指引，将持续夯实经营基本面，提升综合竞争力与盈利能力，积极为股东创造长期价值。感谢您的关注与支持！

5、尊敬的陈总，公司至今业绩有目共睹，但是公司也是有一些短板；尤其是研发体量跟国际巨头差距巨大，比方 IT、MARVEL L，谱瑞都是几十亿甚至上百亿级别，我们也感受到在新拓展板块有很大的技术代差，所以高端市场会很难推动；未来公司将在 H 股上市，公司有没有计划引进更多战略高端人才计划？公司有哪些策略确保公司未来能够追赶上国际优秀企业？

答：尊敬的投资者，您好！人才是半导体企业核心竞争力，公司高度重视高端人才建设，并将依托 H 股上市契机，拓宽国际化融资与引才平台，持续加大全球核心研发、技术架构及高端管理人才引入，完善中长期激励体系，构建国际化研发团队，夯实

人才壁垒。研发端，公司坚持自主创新，稳步提升研发投入，迭代核心技术平台与自研 IP，聚焦车载 SerDes、AR/VR 空间计算、AI 及 HPC 高速传输等关键领域，协同全球供应链优化先进工艺，持续丰富高价值产品矩阵。同时，公司加快全球化布局，深化产业协同，并围绕主业审慎探索战略合作、产业投资及并购整合，补齐技术短板，逐步缩小与国际企业差距，稳步提升长期核心竞争力。感谢您的关注与支持！

二、互动交流

1、请问 24 年股权激励触发值 2026 年营收需 \geq 8.46 亿元难度不小，公司层面是否有信心达到？如果能达到，具体在那些产品上发力突破，请帮投资者分拆一下？

答：尊敬的投资者，您好！公司聚焦高速混合信号芯片主业，按既定战略推进产品迭代与场景拓展，2026 年公司管理层及核心团队将围绕考核目标全力推进经营发展。2026 年，公司将进一步巩固国内视频桥接芯片龙头地位，加大智能视频芯片在大客户的渗透率及在智能端侧的应用拓展；同时在智能车载及 AR/VR 领域积极导入行业标杆客户，提升收入占比及实现示范效应；积极布局高速互连类芯片，推进产品验证与市场导入。感谢您的关注与支持！

2、公司是否考虑收购优质芯片标的，从而提升营收规模和盈利水平？希望公司积极作为，利用资本市场优质资源，通过并购重组实现质的突破和市值有效提升！

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注与建议。公司高度重视产业发展机遇，围绕主营业务与产业链进行前瞻布局，持续关注技术领先、成长性良好且与公司战略高度契合的优质标的。未来将综合评估标的的技术实力、市场空间、协同价值及交易可行性等因素，审慎开展投资并购相关工作，进一步提升核心竞争力与长期盈利能力。如涉及相关事项，公司将严格按照监管规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注与支持！

3、公司有哪些产品具备强大竞争力？市场占有率如何？

答：尊敬的投资者您好！公司依托自主研发的 ClearEdge 高

速混合信号技术平台及核心 IP 储备，持续构建对标国际先进水平的技术竞争力，产品持续优化和拓展 HDMI、DP、MIPI、USB、PCIe 等主流高速接口协议，具备高集成、高可靠、高性价比的综合优势。公司以智能视频桥接与高速信号互连芯片为核心主业，拥有多款 8K 超高清视频转换、多屏互联、AI 端侧等代表性产品；同时公司积极布局车载及 AI 高速互连领域。公司将凭借持续高强度研发投入、完整的产品矩阵及头部生态合作，持续推进市场占有率。感谢您的关注！

4、公司与英伟达在哪些方面有合作？发展空间如何？

答：尊敬的投资者，您好！依托与英伟达的生态合作，公司相关互连芯片和智能视频芯片的市场认可度进一步提升，公司与英伟达在智能座舱、ADAS、车载显示、高端显示领域保持深度参考设计合作，部分产品已量产，协同效应持续释放，未来随着车载与高端显示需求放量，业务规模具备持续扩张潜力。具体进展详见后续公告，感谢您的关注与支持！

5、尊敬的陈总，目前像英伟达 NVIDIA 在芯片设计上已经大量应用 AI，包括设计探索，标准单元库开发、BUG 处理、验证等不同阶段；请问龙迅股份在日常工作过程中有没有积极布局 AI？

答：尊敬的投资者您好！公司始终保持对新技术和新趋势浓厚的学习兴趣，目前在日常研发运营中，已安排专人研究运用 AI 相关工具辅助研发和运营等工作并开展相关培训，以提升公司研发效率、优化设计质量。未来公司将持续跟踪行业技术趋势，深化 AI 工具在日常工作中的应用，进一步提升整体运营与研发效能。感谢您的关注！

6、尊敬的陈总，请问公司多次提及跟英伟达合作，目前已经部分量产；请问主要跟英伟达在游戏、汽车业务还是 AI 算力上？主要提供哪方面的产品？具体体量有多大？

答：尊敬的投资者，您好！依托与英伟达的生态合作，公司相关互连芯片和智能视频芯片的市场认可度进一步提升，公司与英伟达在智能座舱、ADAS、车载显示、高端显示领域保持深度参考设计合作，部分产品已量产，协同效应持续释放，未来随着车

载与高端显示需求放量，业务规模具备持续扩张潜力。具体进展详见后续公告，感谢您的关注与支持！

7、请问公司“核心主力产品：PCIe5.0/CXL2.0 Retimer 芯片（AI 数据中心核心互联芯片）；核心主力产品：PCIe5.0/CXL 2.0 Retimer 芯片（AI 数据中心核心互联芯片）；辅助类 AI 相关互联芯片（服务器 / 存储配套）”哪些已量产？哪些已流片？未流片的预计什么时候能流片？烦请详细告知，给投资者预期。非常感谢

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司产品的关注。公司主要互连芯片研发进展如下：PCIe5.0 Retimer（兼容 CXL2.0）目前在设计开发中，计划 2026 年上半年完成流片；面向数据中心与 AI 集群，用于多设备扩展、算力池化、GPU 互连的 PCIe5.0 / CXL2.0 Switch 目前处于规划与预研阶段；同时，USB 相关产品作为高速互连产品线的重要部分，目前处在研究开发中，具体进展详见后续公告。感谢您的关注与支持！

8、尊敬的陈总，您好！芯片企业，总体来说技术更新较快；人才非常重要，公司的研发中心设在合肥，在国内，相对来说长三角地区，上海是不是跟符合公司吸引更多优秀人才，公司有没有考虑在上海成立子公司的计划？很多传统的老板为了平衡元老员工，很难下大决心高薪聘请更高端人才，请问公司目前有没有更好的政策吸引更多优质人才？

答：尊敬的投资者，您好！

半导体行业技术迭代快速，核心人才是企业创新发展的关键要素。公司深耕合肥研发基地，依托区域产业与科教资源，已构建稳定成熟的研发团队。同时公司充分认可上海作为长三角集成电路核心城市的人才集聚与产业协同优势，现阶段暂无设立上海子公司的相关规划，未来若有区域布局调整计划，公司将严格依规及时履行信息披露义务。

人才建设方面，公司始终将引才、育才、留才置于战略高度，持续搭建完善的培养体系与双通道发展路径，建立具备市场竞争力的薪酬体系，配套绩效奖励、股权激励等多元化长效激励机制，持续优化研发创新环境。

此外，公司积极推进 H 股上市布局，依托国际化平台进一步拓宽人才引入渠道，持续吸纳行业优质人才，稳固研发核心力量，为公司长期高质量发展提供坚实支撑。

感谢您的宝贵建议以及对公司的关注与支持！

9、尊敬的陈总，您好！AI 及 HPC 领域收入规模 2025 年多少？公司开发 PCIe/CXL/USB 的 Retimer 及 Switch，其中 PCIe5.0 Retimer（可与 CXL2.0 兼容）公司年报有提到已取得显著进展；目前是否流片？另外 Swich 进展如何，公司是否已经立项？另外公司车规级认证持续完善，自研 ADP 协议的车载 SerDes 进展情况，以及市场推广如何？

答：尊敬的投资者，您好！AI 及 HPC 领域作为公司的战略新业务方向，是公司全新成长赛道，根据已公开数据，该领域 2025 年前三季度收入占公司前三季度总收入 2% 左右。PCIe5.0 Retimer（兼容 CXL2.0）目前在设计开发中，计划 2026 年上半年完成流片。面向数据中心与 AI 集群，用于多设备扩展、算力池化、GPU 直连互联的 PCIe5.0 / CXL2.0 Switch 目前处于规划与预研阶段。USB 相关产品作为高速互连产品线的重要部分，目前处在研究开发中，具体进展详见后续公告。智能车载作为公司的业务新增长曲线，公司持续强化该领域建设，截至目前，公司已有 20 款车载芯片通过 AEC-Q100 认证，车载 SerDes 芯片组已全面推向市场。近期，顺利通过 ISO26262:2018 功能安全管理体系认证，此次认证通过，表明公司已建立起完善的功能安全管理体系，可满足智能座舱、ADAS 等核心车载场景的严苛安全要求，技术实力与管控水平全面接轨国际标准。公司将持续推进包括车载 SerDes 在内的汽车电子业务，具体进展详见后续公告，感谢您的关注与支持！

10、公司今年订单如何？同比是否增长？未来发展前景如何？

答：尊敬的投资者，您好！目前公司在手订单充足，日常订单承接与交付高效有序。公司将持续聚焦核心主业，坚持研发创新，不断优化产品结构与市场布局，稳步提升核心竞争力，夯实

持续经营能力。感谢您的关注与支持！

11、陈总你好，贵公司产品在 AI 算力互连上的应用主要运营在哪些方面？随着 AI 算力的高速发展，贵司除了高速互连芯片，还有哪些芯片布局？谢谢

答：尊敬的投资者您好。公司目前在 AI 运力方面主要开发的产品是面向 AI 服务器与 HPC 场景的 PCIe 5.0 Retimer（兼容 CXL 2.0），同时公司还在高端显示、智能驾驶、端侧空间计算等高端应用上积极布局新产品。感谢您的关注！

12、公司以后在获得重大订单时能不能自愿性披露一下，从而提振投资者信心？

答：尊敬的投资者，您好！

感谢您的宝贵建议与关注。公司严格遵守证监会、交易所信息披露相关规则，对于达到法定披露标准的重大合同及经营事项，将及时履行审议与公告义务，保障信息披露的公平、合规与透明。公司将在合规前提下，合理优化经营信息传递，通过定期报告、投资者交流等方式，客观展现公司经营基本面与发展情况。同时持续稳健经营，夯实核心竞争力，维护全体投资者利益。

感谢您的理解与支持！

13、董事长股份已经解禁，近期公司股价比较弱，远落后于同行业芯片半导体板块，董事长能不能自愿性承诺半年或者三个月内不减持，从而有效提振投资者信心，做好市值管理工作！谢谢董事长！

答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的宝贵建议与对公司的关心。我们高度关注近期公司股价表现及行业对比情况，也充分理解您希望稳定市场预期、提振投资者信心的诉求。本人及公司管理层始终对公司长期发展前景充满信心。公司始终坚持以提升经营业绩、强化核心竞争力为根本做好市值管理，切实维护全体股东利益。本人截至目前并无减持公司股份的计划，后续如有相关安排，将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。再次感谢您的关注与支持！

14、您好。作为投资者，我注意到贵公司 2024 年及本次均未

采用直播形式的业绩说明会并提供视频回放。业绩说明会有助于投资者全面了解公司经营和管理层观点，支持理性决策。缺少视频直播或回放可能使投资者信息获取不够充分与直观。请问贵公司在 2025 年的业绩说明会中，是否考虑采用视频直播并提供会后回放，以便投资者能够更加便捷、充分地获取相关信息？感谢解答。

答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年度业绩说明会于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 09:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开，具体内容详见公司已公开披露的《龙迅股份 2025 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表（龙迅股份 2024 年度业绩说明会）》。

公司 2025 年年度业绩说明会于今日在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开，会后公司将及时公开披露《龙迅股份 2026 年 4 月 15 日投资者关系活动记录表（龙迅股份 2025 年年度业绩说明会）》。

感谢您的关注与支持！

15、董事长您好，请问公司 PCIe5.0/CXL2.0 Retimer 芯片、辅助类 AI 相关互联芯片哪些已量产？哪些已流片？未流片的预计什么时候能流片？烦请加强交流，详细些回复，非常谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司产品的关注。公司主要互连芯片研发进展如下：PCIe5.0 Retimer（兼容 CXL2.0）目前在设计开发中，计划 2026 年上半年完成流片；面向数据中心与 AI 集群，用于多设备扩展、算力池化、GPU 互连的 PCIe5.0 / CXL2.0 Switch 目前处于规划与预研阶段；同时，USB 相关产品作为高速互连产品线的重要部分，目前处在研究开发中，具体进展详见后续公告。感谢您的关注与支持！

16、陈总你好，视频桥接芯片全球前五、国内第一的地位，但是总体营收还是在整体市场份额占比中较小，贵司 2026 年如何继续提升份额？消费电子复苏对公司贡献有多大？

答：尊敬的投资者您好！2026 年公司将持续技术迭代与产品升级，强化与 TI、ADI 等国际巨头的对标竞争力，抢占高端市场份额；推动车载和新兴应用放量，加速车载 SerDes、座舱多

| | |
|--------------|--|
| | <p>屏、HUD、ADAS 产品渗透，深化与车企知名客户合作，同时扩大 AR/VR、工业显示、医疗等新场景出货，打开增量空间；做好生态维护与客户渗透，深化与高通、英特尔、英伟达等主芯片平台的参考设计合作，加快覆盖全球终端供应链；优化境内外服务体系，提升交付与定制响应效率，巩固头部客户、拓展中小客户覆盖；同时，深化与全球代工厂合作，加快先进工艺导入，做好产能与供应链保障。公司注重多元均衡布局应用领域，具备一定的抗周期属性，消费电子回暖将对公司该领域的收入提升形成利好因素，公司将把握机遇，进一步扩大公司业绩。感谢您的关注！</p> |
| 是否涉及应当披露重大信息 | 否 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2026 年 4 月 15 日 |